

# MEMO

致 To : 各會員  
 由 From : HKPCA 秘書處

編號 Ref. no. : M-15-057  
 日期 Date : 2015 年 7 月 27 日

## 2015 年 8 月份培訓課程 2015 August Training Course

課題 Topic:	下一代線路板細線路製造工藝-改良型半加成法工藝 Next Generation Process for Fine Pitch PCB Manufacturing - Modified Semi-Additive Process (MSAP)
日期 Date:	2015 年 8 月 28 日(星期五) / August 28, 2015 (Friday)
時間 Time:	2:00-5:00 PM
地點 Venue:	深圳前海華僑城 JW 萬豪酒店 深圳市寶安中心區寶興路 8 號一樓會議室 1 號廳(地鐵環中線:寶華站 D 出口)
培訓目的 Training objective:	由市場, 製造工藝以及應用來了解改良型半加成法 (MSAP) 技術。 To introduce MSAP technology from Market, manufacturing and applications perspective
課程內容 Course Content:	1. 封裝載板市場現況與動態 IC Substrate Market Outlook 2. 改良型半加成法於封裝載板電路板的應用範疇 MSAP Application Window for IC Substrate PCB 3. 改良型半加成法使用於封裝載板電路板之製造工藝流程 MSAP Manufacturing Process Flow Introduction on IC Substrate PCB 4. 下一代高精密 HDI 電路板挑戰與解決方案 Solution for HDI Fine Pitch Challenge
培訓對象 Target Audience:	電路板製造相關從業人員, 尤其是封裝載板與高密度互連板領域 PCB production related persons, especially in IC Substrate and HDI field.
講師 Information of speaker:	林嘉弘, 大同大學化學工程學系學士, 台北科技大學工業工程與管理 EMBA 班碩士。現任陶氏化學電子材料公司全球策略營銷經理。曾任耀華電子股份有限公司資深研發工程師、陶氏化學電子材料公司金屬化應用亞洲區產品營銷經理。 Lin, Marc (Chia-Hung), Master's Degree obtained at National Taipei University of Technology EMBA, Bachelor's Degree obtained at Tatung University Chemical Engineering. Mr. Lin's present job title is Global Strategic Marketing Manager at Dow Chemical Company. His previous job titles were Senior R&D Engineer at Unitech Printed Circuit Board Company and Asia Marketing Manager for Metallization at Dow Chemical Company.
語言 Language:	中文 / Chinese

<p>费用 Fee:</p>	<p>本会会员-每位 HK\$370, 或 RMB310 (含税): 费用包括讲义、茶点, 精工活动举行前办妥缴费事宜, 逾期作取消论。如属同一公司多人报名, 可获以下优惠 (此优惠只限公司会员):</p> <p>3 人至 4 人-每位 HK\$320 或 RMB270(含税)</p> <p>5 人或以上-每位 HK\$250 或 RMB210(含税)</p> <p>非本会会员-每位 HK\$570 或 RMB480 (含税): 费用包括讲义、茶点。</p> <p>Member - HK\$370, or RMB310 per head (including tax): The fee includes handouts and refreshments. Please settle the payment before the event, or reserved seats will be cancelled. If more than one people of the same company signed up for training, bulk discount will be offered (For corporate members only):</p> <p>3 to 4 persons- HK\$320 or RMB270 per head (tax included)</p> <p>5 or more persons - HK\$250 or RMB210 per head (tax included)</p> <p>Non-members - HK\$570 or RMB480 per head (including tax): fee includes handouts, refreshments.</p> <p><b>备注: 不设现场收费, 烦请于课程开始前 3 天付清。</b></p> <p><b>如在截止日期后, 已报名之人士需作取消, 费用将不作退还。</b></p>	
<p>缴款办法 Payment Method</p>	<p>人民币电汇: 户名: 港粤线路板科技咨询(深圳)有限公司 开户行: 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 帐号: 7559 1878 8810 201 深圳秘书处地址: 中国广东省深圳市南山区桃园路 171 号深圳平安银行(原深圳发展银行)南山大厦 13A2 室</p>	<p>港币电汇: 银行名称: 香港上海汇丰银行有限公司 账户名称: 香港线路板协会有限公司 帐户号码: 469-089601-838 银行电汇编号: HSBCHKHKKH 香港办事处地址: 香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 22 楼 B 室 Bank name : HSBC Bank A/C Name : Hong Kong Printed Circuit Association Ltd. Bank A/C No: 469-089601-838 Swift Code: HSBCHKHKKH Hong Kong Office Address: Unit B, 22/F., Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, H.K.</p>
<p>截止日期 Deadline:</p>	<p>2015 年 8 月 25 日 (星期二) /August 25, 2015 (Tuesday)</p>	
<p>查询 Enquiry:</p>	<p>深圳秘书处: 全小姐 Eva Quan; Tel#: (86) 755 8624 0033; Email ID:evaquan@hkpca.org 袁小姐 Susan Yuan; Tel#: (86) 755 8624 1673; Email ID:susanyuan@hkpca.org</p>	

## 回条 Reply Form

### 2015 年 8 月份培训课程

日期: 2015 年 8 月 28 日 (星期五)  
 时间: 14:00 ~ 17:00  
 地点: 深圳前海华侨城 JW 万豪酒店一楼会议室 1 号厅

**请于 2015 年 8 月 25 日(星期二)前回复**  
**Please reply by August 25, 2015 (Tue)**  
 传真号码 Fax#: 755-86240022  
 电邮地址 Email ID : evaquan@hkpca.org

致: HKPCA/PRC 秘书处  
 本人/吾等希望参加 2015 年 8 月 28 日培训课程  
 本人/本公司为 HKPCA 会员, 会员编号: \_\_\_\_\_。

**参加者详情:**

人数	参加者姓名(必填)		职位	参加培训者	学历(请选择一项)			是否需要培训证
	英文	中文		手机号(必填)	预科或以下	大专或大学	硕士或博士	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

- 说明:**
- 需要培训证的学员请在「是否需要培训证」一栏中进行选择, 并填妥中英文名, 无中文名的除外。
  - 培训证将在当次培训课程结束后, 发放给学员本人; 若参加者有变动请于截止日期前通知本会。

**对是次课程之期望** (请务必填写): \_\_\_\_\_

**费用:**

参加人数共 \_\_\_\_\_ 人 × 每人港币/人民币 \_\_\_\_\_ = 合共总额港币/人民币 \_\_\_\_\_

备注: 不设现场收费, 烦请于课程至少三天前付清。

**联络人数据:**

公司名称: \_\_\_\_\_  
 公司地址: \_\_\_\_\_  
 姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_  
 电邮地址: \_\_\_\_\_ 传真号码: \_\_\_\_\_

**\*\*\*截止报名日期: 2015 年 8 月 25 日(星期二)\*\*\***